

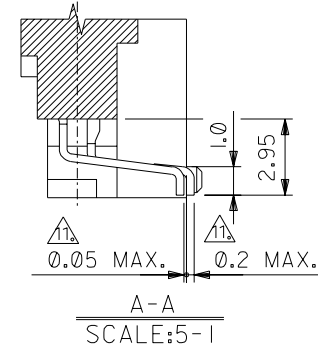
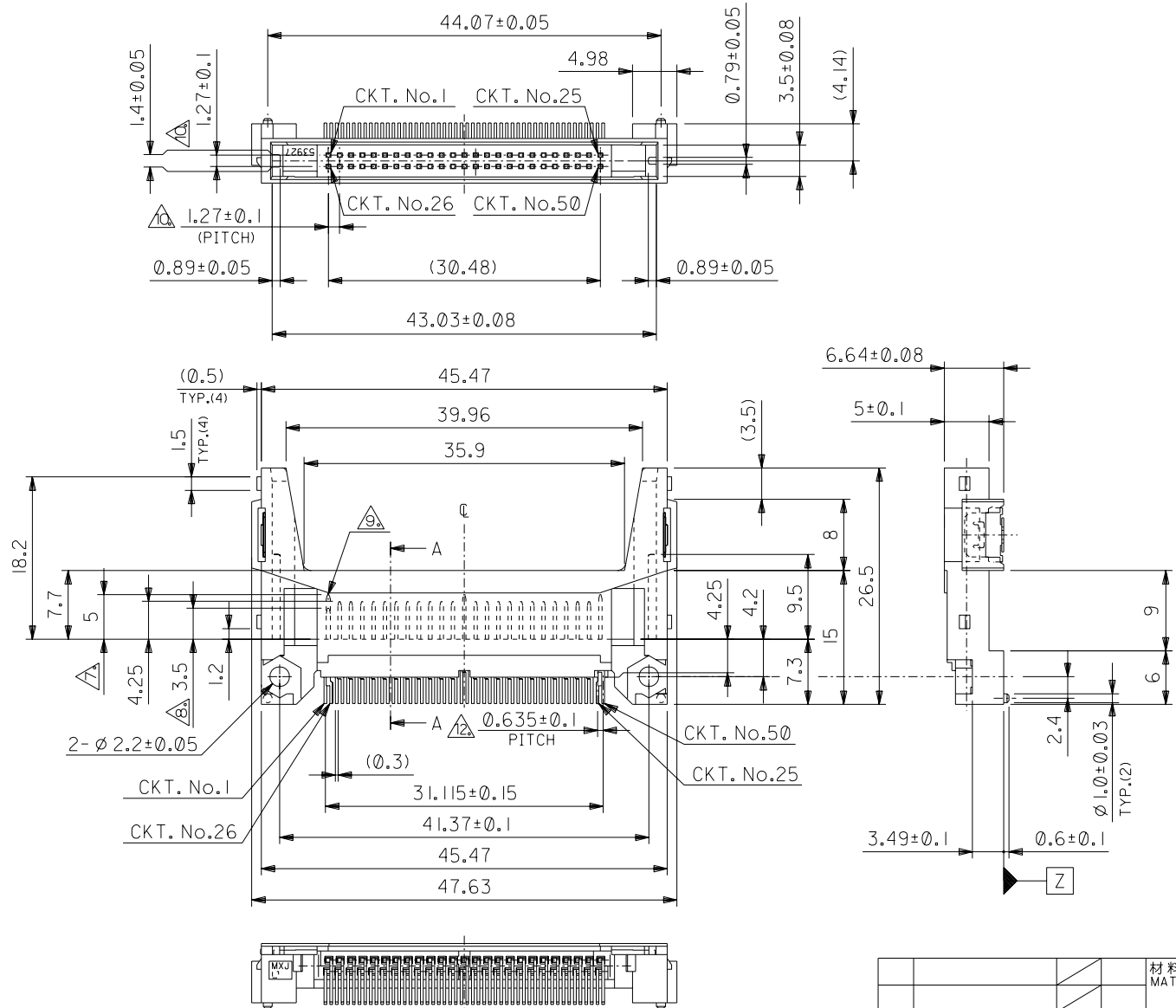
DWG. NO.  
SD-53927-001

E

D

DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

A



53927-**19	53927-5019
MODEL No.	MATERIAL No.

材料 MATERIAL		SEE NOTES	molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
仕上げ FINISH		SEE NOTES	REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
適用電線範囲 WIRE RANGE		— # —	TITLE 名称 CFA CARD CONN. 50P HEADER ASS'Y (REVERSE TYPE) -LEAD FREE-	
被覆外径 INS. RANGE		— # —	DWG. NO. SHEET 1 OF 2 REV	
DRAWN BY '04/05/17 T.UENO		CHK'D BY '04/05/17 M.SASAO	SD-53927-001 0	
APP'D. BY '04/05/17 M.SASAO		尺 度 SCALE 2 - 1		
角度 ANGLE	±3°			
30以上 OVER	+0.3			
10以上 OVER 30未滿 UNDER	+0.25			
未滿 UNDER	+0.2			
一般公差 GENERAL TOLERANCES	0	新規作成 RELEASED (J2004-4268)	T.U.	'04/05/17
記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE	

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION  
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので 会社の許可なく複製を禁止する。 EN-01C(032)MXJ-32

8

7

6

5

4

3

2

1

SD-53927-001.501

DWG. NO. SD-53927-001

DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

注)  
 NOTES 1. 材質  
 MATERIAL  
 ハウジング：ガラス入りLCP UL94V-0  
 HOUSING: LCP G.F. UL94V-0  
 ピン：リン青銅  
 PIN: PHOSPHOR BRONZE  
 ネール：リン青銅  
 NAIL: PHOSPHOR BRONZE

2. メッキ仕様  
 PLATING  
 PIN 接点部：パラジウムニッケル下地、金メッキ  
 CONTACT AREA: Au OVER Pd-Ni  
 半田付け部：錫メッキ  
 SOLDER TAIL AREA: TIN  
 下地メッキ：ニッケルメッキ  
 UNDERPLATING: NICKEL OVER ALL

NAIL 錫メッキ  
 TIN  
 下地メッキ：ニッケルメッキ  
 UNDERPLATING: NICKEL OVER ALL

3. 推奨基板厚：t0.8 MIN.  
 RECOMMENDED P.C.B. THICKNESS: t0.8 MIN.

4. 適合カード厚  
 RECOMMENDED CARD THICKNESS  
 接続部：3.3±0.1  
 CONNECTING AREA: 3.3±0.1

5. 適合カード幅：42.8±0.1  
 RECOMMENDED CARD WIDTH: 42.8±0.1

6. ハウジング色：白  
 HOUSING COLOR: WHITE

△7 寸法適用極：1,13,38,50  
 THIS DIMENSION APPLIES TO CIRCUIT NUMBERS  
 1,13,38 AND 50.

△8 寸法適用極：25,26  
 THIS DIMENSION APPLIES TO CIRCUIT NUMBERS 25 AND 26.

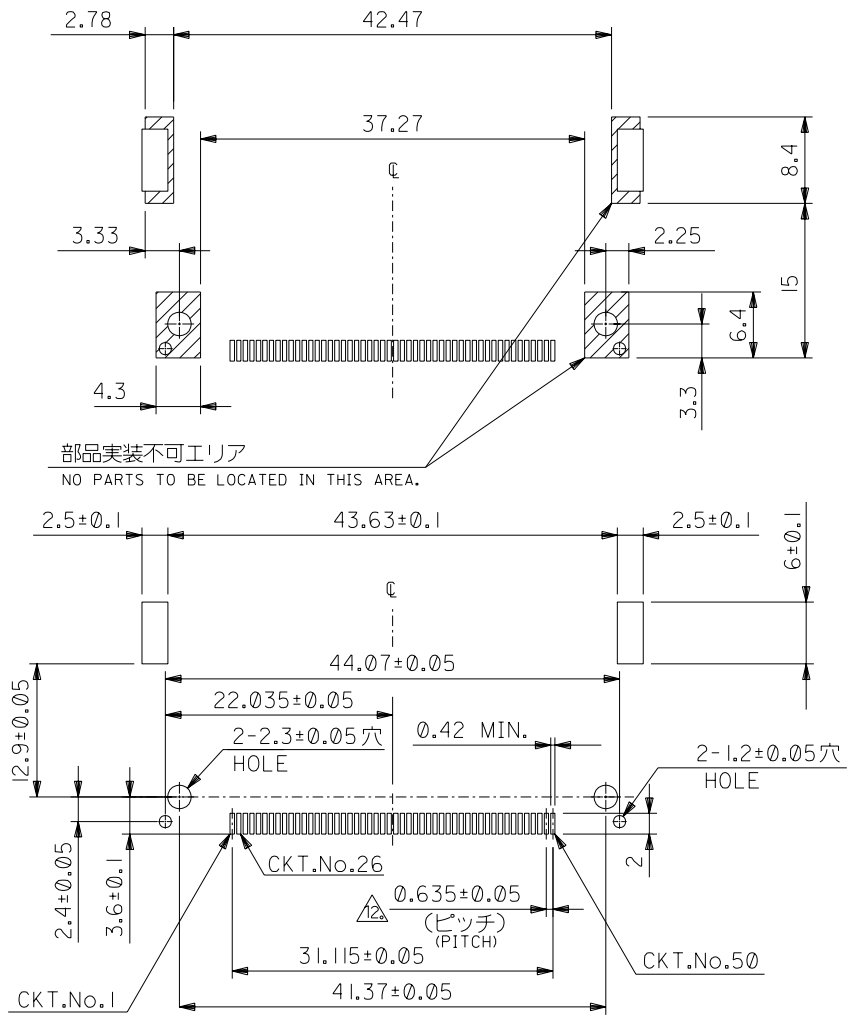
△9 ピンの倒れは、ピン根元を基準に全方向へ0.1 MAX.とする。  
 PIN TIP LEAN TOWARD ANY DIRECTION NOT TO EXCEED 0.1  
 WHEN MEASURED FROM PIN BASE.

△10 ピン根元に適用する。  
 THIS DIMENSION TO BE MEASURED AT PIN BASE.

△11 ソルダータールは、Z面を基準とし上へ0.05下へ0.2の範囲にあり、  
 且つソルダータールの平坦度は、0.15 MAX.とし、テール先端にて測定する。  
 SOLDER TAILS TO BE WITHIN 0.05 UPWARD AND 0.2 DOWNWARD FROM Z-DATUM PLACE, AND COPLANARITY OF  
 SOLDER TAILS TO BE WITHIN 0.15.  
 MEASUREMENT POINT IS SOLDER TAILS TIP.

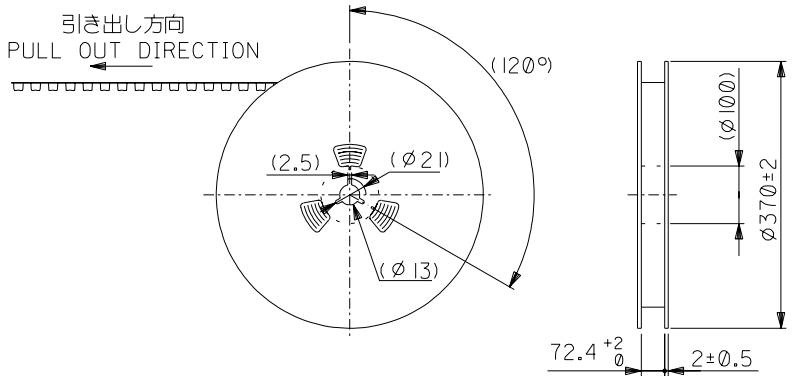
△12 公差非累積  
 NON-CUMULATIVE

13. 本製品は 53927- \*\* 10 の鉛フリー一品である。  
 THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 53927- \*\* 10.



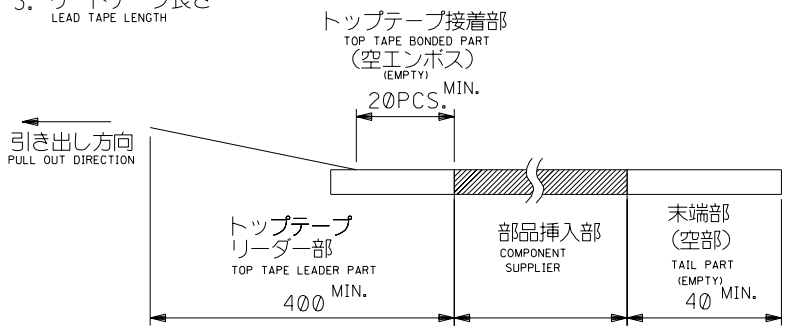
基板推奨寸法  
 RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT

		↑		材料 MATERIAL		— # —		molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
				仕上げ FINISH		— # —		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
				適用電線範囲 WIRE RANGE		— # —		TITLE 名称 CFA CARD CONN. 50P HEADER ASS'Y (REVERSE TYPE) -LEAD FREE-	
				被覆外径 INS. RANGE		— # —		DWG. NO. SHEET 2 OF 2 REV	
				DRAWN BY 04/05/17 T.UJENO		CHK'D BY 04/05/17 M.SASAO		SD-53927-001 0	
				APP'D BY 04/05/17 M.SASAO		尺度 SCALE 2 - 1			
角度 ANGLE	±3°			記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	日付 DATE			
30° 以上 OVER	+0.3			0	SEE SHEET 1 OF 2	11/17 M.S	04/05/17		
10° 以上 OVER 30° 未満 UNDER	+0.25								
10° 未満 UNDER	+0.2								
一般公差 GENERAL TOLERANCES									



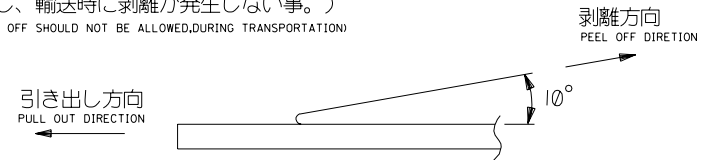
注)  
NOTES

- 製品番号 53927-5019 の詳細寸法については、SD-53927-001 を参照下さい。  
IN THE PACKAGE , PART NO. 53927-5019 DETAILED DIMENSIONS , SEE SD-53927-001
- 梱包数量 : 280 個/リール  
NUMBER OF CONNECTORS : 280 PCS/REEL
- リードテープ長さ  
LEAD TAPE LENGTH



- トップテープの剥離強度: (剥離方向は下図参照)  
PEELING OFF FORCE OF TOP TAPE (PEELING DIRECTION AS SHOWN IN FOLLOWING FIG.)  
0.1~1.3N {10~130gf} : キャリアテープ幅72mm  
CARRIER TAPE WIDTH 72mm

尚、本規格値は、出荷時に適用。  
THIS REQUIREMENT SHOULD BE APPLIED AT SHIPMENT  
(但し、輸送時に剥離が発生しない事。)  
(PEEL OFF SHOULD NOT BE ALLOWED.DURING TRANSPORTATION)



- 材料  
MATERIAL  
キャリアテープ : ポリプロピレン (PP)  
CARRIER TAPE : POLYPROPYLENE (PP)  
トップテープ : PET, PE, PEF  
TOP TAPE : PET, PE, PEF  
リール : 紙  
REEL : CARD BOARD

- 本製品は 53927- \*\* 18 の鉛フリー品である。  
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 53927- \*\* 18.

53927- ** 78	53927-5078	50
MODEL NO.	MATERIAL NO.	種数 NO. OF CKTS.

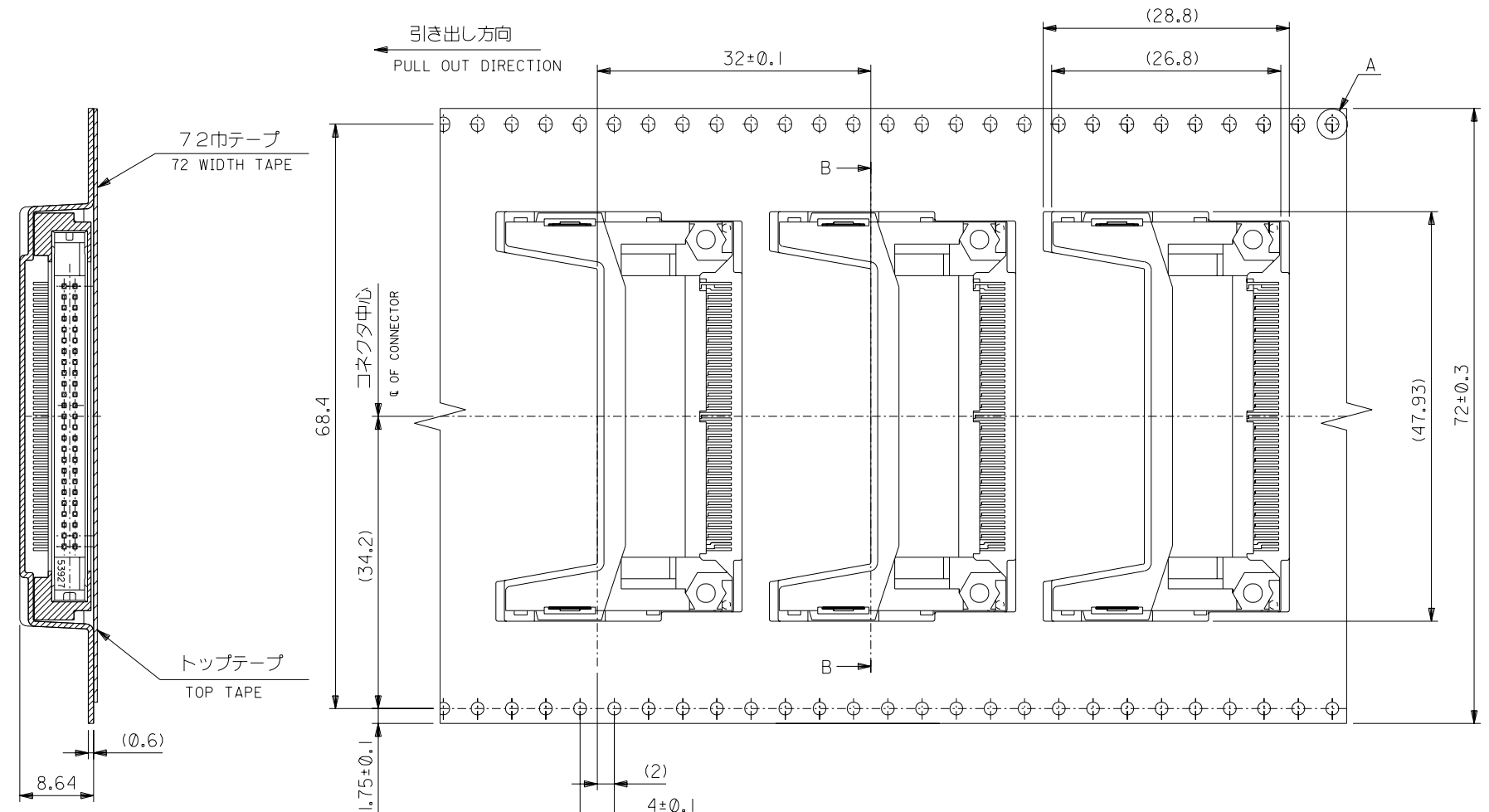
材料 MATERIAL		注参照 SEE NOTES		molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
仕上げ FINISH		---		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
適用電線範囲 WIRE RANGE		---		TITLE 名称 53927-5019 TAPING PACKAGE -LEAD FREE-	
被覆外径 INS. RANGE		---		DRAWN BY 04/05/17 T.UENO CHK'D BY 04/05/17 M.SASAO	
DRAWN BY 04/05/17 T.UENO		CHK'D BY 04/05/17 M.SASAO		DWG. NO. (SHEET 1 OF 2) REV	
APP'D BY 04/05/17 M.SASAO		尺度 SCALE		SD-53927-002 0	

角度 ANGLE	+30		
30 以上 OVER	+0.3		
10 以上 30 未満 UNDER	+0.25		
10 未満 UNDER	+0.2		
一般公差 GENERAL TOLERANCES			

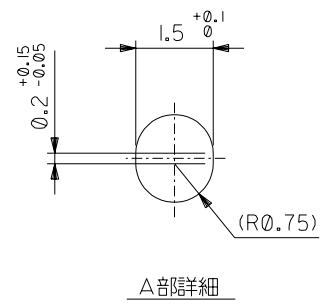
記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE
0	新規作成 (J2004-4268) RELEASED	T.U.	04/05/17

DWG. NO.  
SD-53927-002

ALL DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING



断面 B - B  
SECTION B-B



累積ピッチ : 40±0.2  
ACCUMULATIVE  
PITCH : 40±0.2

角度 ANGLE	+30					材料 MATERIAL	注参照 SEE NOTES	MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社
30 以上 OVER	+0.3					仕上げ FINISH	—	
10 以上 30 未満 OVER 30 UNDER	+0.25					適用電線範囲 WIRE RANGE	—	TITLE 名称
10 未満 UNDER	+0.2					被覆外径 INS. RANGE	—	53927-5019
一般公差 GENERAL TOLERANCES		SEE SHEET 1 OF 2				DRAWN BY 04/05/17 T.UENO	CHK'D BY 04/05/17 M.SASAO	TAPING PACKAGE
記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE	APP'D BY 04/05/17 M.SASAO	尺度 SCALE	2 - 1		-LEAD FREE-
						DWG. NO.	(SHEET 2 OF 2)	REV
						SD-53927-002		0